# Branson IPC3000







WWW.NJTSL.COM

## 主要特点和用途

Branson IPC系列去胶机属经济的、高产能的多桶式去胶系统,该系统以工业标准设计、制造,已经成为了当今世界领先半导体厂家降低成本、提高生产率的最佳选择。它使用于不同形状的晶片:圆形、方形及异性等,加工尺寸从2英寸到8英寸均可。独立的闭环控制系统,确保加工器件参数达到最优。

#### 工艺用途:

- 打胶(去胶);
- 去除底膜以提高光刻工艺成品率;
- LED晶片打胶;
- MEMS工艺清洗,工艺流程可延至4h;

### 技术参数

	主要技术指标	原厂指标	升级后的指标
GAS 控制	MFC 控制	无	新增 MFC 控制功能
压力控制	自动控制	无	新增压力自动检知及蝶阀控制
软件功能	控制器	手动控制	奔腾 PC 机
	用户界面	文本界面	触摸屏图像界面(GUI)
	数据存储	无	工艺数据存于硬盘
	工艺菜单编辑	文本菜单,项目有限	图像界面、简单、直观、方便
	在线帮助	无	多语言在线帮助
校准功能	温度校准	手动校准,繁琐	软件校准,方便精准
	压力校准	手动校准,繁琐	软件校准,方便精准
	气体校准	手动校准,繁琐	软件校准,方便精准
故障诊断功能		功能有限	提供丰富的诊断功能及故障分析解答,
			实时显示输入输出(I/O)部件状态,
			状态位于显示屏,更方便维护和维修
A/D 精确性		12bits	16bits
RF 控制	自动控制	无	软件自动检知及控制 ENI、RF 源

## 物理参数

外围条件	电源: 380V AC, 3P+N+G,50HZ, 30Amp 冷却循环水: 流量 1.5GPM,压力: 40psi-60psi,3/8 SWAGELOK 工艺气体: 标准 O2 和 N2; 压力: 20psi-30psi(最大≤40psi), 纯度 99.999%		
	压缩空气: 80psi-90psi, N2 或干燥无油压,流量: 1scfm, 系统排气: 流量: 200scfm,压力: 0.5-0.75 H2O		
设备尺寸	主机: 85cm 宽×92cm 深×44cm 高 控制器: 56cm 宽×44cm 深×28cm 高 净重: 150kg		

电 话: 025-84440211 传 真: 025-84360850 邮 编: 210014

地 址: 江苏省南京市玄武区柳营100号

E-mail :info@njtsl.com